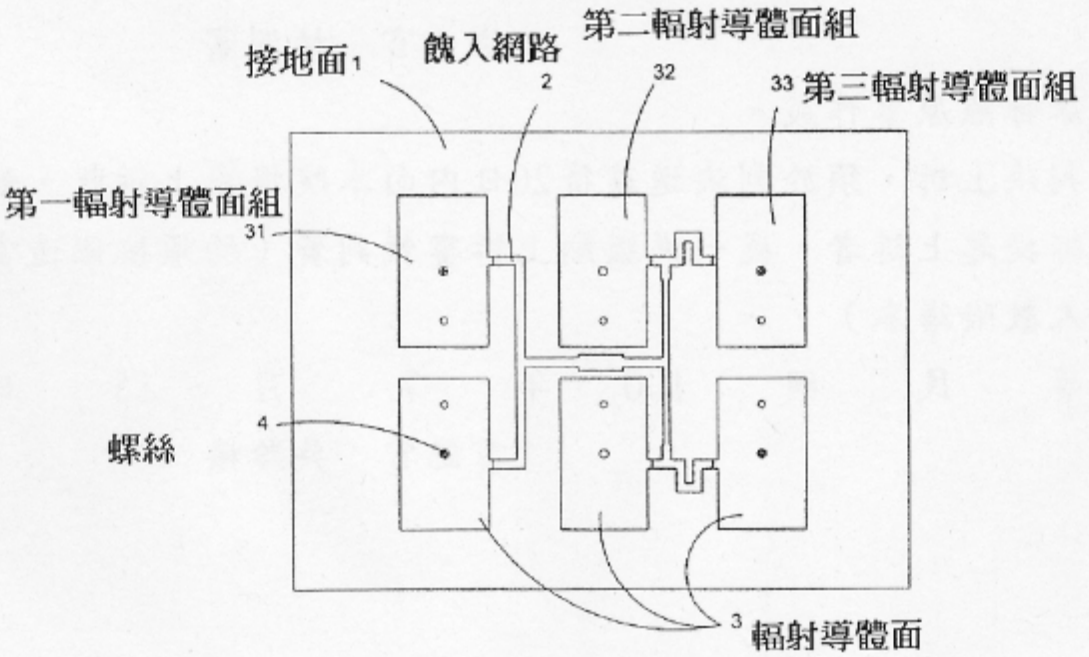
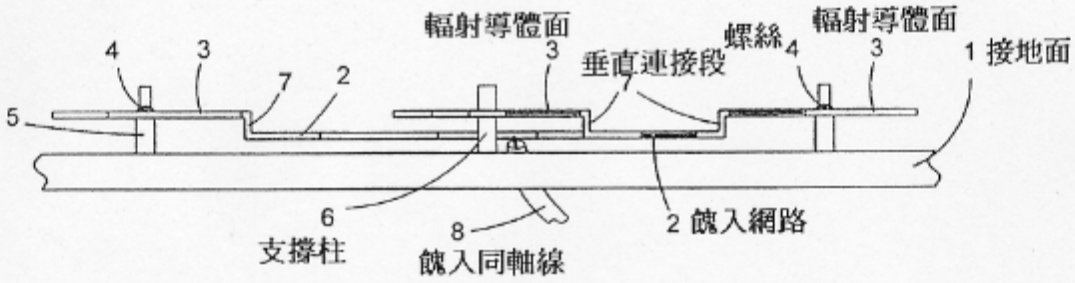
附圖 1：系爭專利



第 1 圖



第 2 圖

附圖 2：引證案

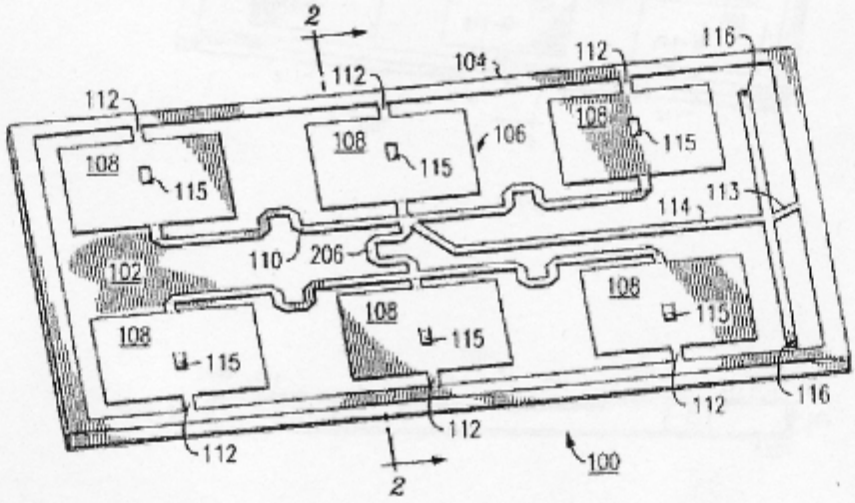


FIG. 1

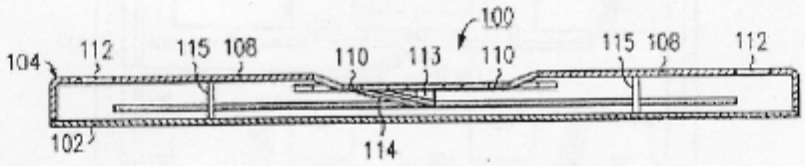


FIG. 2

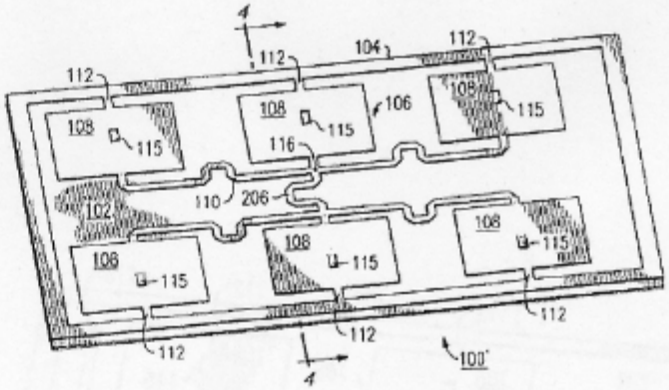


FIG. 3

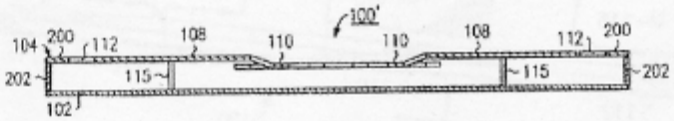


FIG. 4

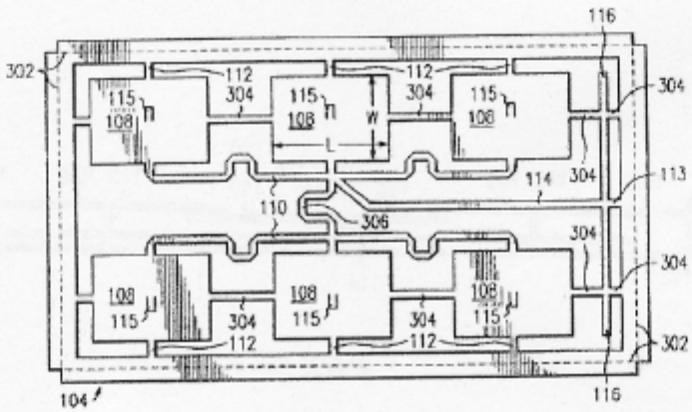
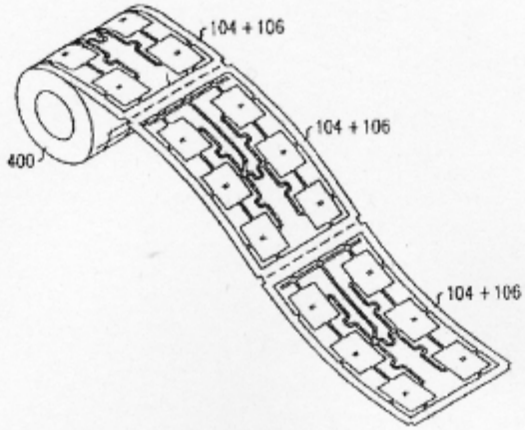


FIG. 5



附表：系爭專利之申請專利範圍第1項分析

項目編號	系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵	被訴產品技術內容	是否文義讀取
A	一種一體式陣列天線	a：一體式陣列天線	是
B	由一接地面、複數個饋入網路及複數個輻射導體面所組成	b：由一接地面、6個饋入網路連接形成一走線及6個輻射導體面所組成	是
C	複數個輻射導體面呈現陣列式排列	c：6個輻射導體面呈現陣列式排列	是
D	複數個饋入網路則分別與複數個輻射導體面電性連接	d：6個饋入網路則分別與複數個輻射導體面電性連接	是
E	複數個輻射導體與接地面間隔有一固定空間	e：複數個輻射導體與接地面間隔有一固定空間	是
F	複數個輻射導體面與複數個饋入網路係由一整片金屬所彎折製成	f：複數個輻射導體面與複數個饋入網路係由一整片金屬所彎折製成	是
G	輻射導體面與饋入網路係在不同之水平高度位置	g：輻射導體面與饋入網路係在不同之水平高度位置	是
結論	基於全要件分析，被訴侵權物之技術內容為系爭專利申請專利範圍第1項對應之技術特徵文義讀取。		